|  |
| --- |
| **2023年度 東京都立産業技術高等専門学校****スタートアップ教育支援プログラム「地動計画」****第１期　志望理由書** |
| **年** | **コース** | **番** | **氏名：** |

**送付先：kikaku@jmj.tmu.ac.jp**

|  |
| --- |
| 1. **地動計画に参加を希望する理由について、その背景もふまえて記入してください（250字～330字）。**

《入力時参考：MS明朝　16ポイント×28字×12行以内》 |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **以下のお題①～③のいずれかを選択し、そのお題に応じた写真をまずは撮影してください。そして、その写真を撮影した理由を含めて、撮影した内容を見て思ったこと、考えたこと等を自由に説明してください（200字～400字）。**

**＜お題＞****①日常にあるモノゴト・あたりまえの中で疑ってみたもの【疑】****②技術的にすごい・面白い・気になると思ったもの【技】****③これで遊んでみたいと思ったもの【戯】****※上記は、地動計画のカリキュラムコンセプト「疑技戯」に沿ったお題となっています。****- 疑：見つめ直すこと****- 技：取り扱うこと****- 戯：遊びの中で見つける****※写真の貼り付けが難しい場合は、文字(文章)で説明してもOKです。**《入力時参考：MS明朝　16ポイント×28字×15行以内》 |
| ●撮影写真●タイトル●撮影内容の説明 （上記の写真を撮影した理由含め） |